

海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司 使用部分募集资金和自有资金 向全资子公司增资实施募投项目的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司部分募集资金和自有资金向全资子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）增资实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]430号），公司于2020年4月首次公开发行A股620,068,200股，每股发行价人民币3.89元，募集资金总额为人民币2,412,065,298.00元，扣除发行费用人民币127,675,510.47元后，实际募集资金净额为人民币2,284,389,787.53元。上述募资资金已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第0303号《验资报告》予以确认。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见2020年4月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金主要用于“集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目”（以下简称“300mm硅片二期”）和“补充流动资金”，具体使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	项目总投资额 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)	实际募集资金拟投 入金额(万元)
----	----------	----------------	-------------------	---------------------

1	集成电路制造用300mm 硅片技术研发与产业化二期项目	217,251.00	175,000.00	159,907.29
2	补充流动资金	75,000.00	75,000.00	68,531.69
	合计	292,251.00	250,000.00	228,438.98

三、本次增资的基本情况

（一）本次使用部分募集资金和自有资金增资的情况

公司首次公开发行股票募投项目中“300mm 硅片二期”的实施主体为公司全资子公司上海新昇。为保障募投项目的顺利实施，公司拟对其增资1,600,000,000元，其中募集资金增资1,599,072,851.27元（含募集资金借款转增股本500,000,000元），自有资金增资927,148.73元。本次增资完成后，上海新昇注册资本将由78,000万元变更为238,000万元，公司仍持有上海新昇100%的股权。

公司对募集资金借款转增股本事项的具体情况如下：

1、募投项目中“300mm 硅片二期”的实施主体为上海新昇。2020年4月，公司持有上海新昇98.5%的股权。为保障募投项目的顺利实施以及方便公司的管理，公司使用募集资金50,000万元向上海新昇提供借款专项用于实施募投项目。借款期限为自借款发放之日起6个月，同时采用市场利率收取利息。若在借款期限内，上海新昇成为公司全资子公司（以完成工商变更登记为准），则自完成工商变更登记之日起，不予计息，转为无息借款。具体内容详见公司2020年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《沪硅产业关于使用部分募集资金向上海新昇提供借款实施募投项目的公告》。2020年5月8日，公司将该笔借款划拨至上海新昇开立的募集资金专户。

2、2020年5月，公司以现金2,995.8912万元收购了上海新阳半导体材料股份有限公司持有的上海新昇1.5%的股权。具体内容详见公司2020年6月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《沪硅产业关于收购上海新昇少数股东股权暨关联交易的公告》。2020年6月8日，上海新昇完成工商变更登记，成为公司的全资子公司。

3、2020年6月，为进一步推动募投项目的实施，公司决定以募集资金和自有增资上海新昇实施募投项目。除募集资金现金1,099,072,851.27元和自有资金现金927,148.73元外，还将在上海新昇清偿上述借款自2020年5月8日至2020

年6月7日期间产生的利息1,657,638.89元后，将借款本金转为对上海新昇的增资款。

（二）本次增资对象的基本情况

公司名称：上海新昇半导体科技有限公司

成立时间：2014年6月4日

法定代表人：李炜

注册资本：人民币78000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路1000号1-4幢、6-19幢

经营范围：高品质半导体硅片研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海硅产业集团股份有限公司持股100%

经具有证券、期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海新昇截至2019年12月31日经审计资产总额3,080,418,638.21元、负债总额2,424,676,375.76元、净资产总额655,742,262.45元，2019年度经审计营业收入215,181,145.67元、净利润-109,455,972.50元。

上海新昇截至2020年3月31日未经审计资产总额3,090,083,308.36元、负债总额2,498,385,517.35元、净资产总额591,697,791.01元，2020年第一季度未经审计营业收入63,946,831.52元、净利润-65,549,233.95元。

四、本次增资对公司的影响

本次公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司上海新昇进行增资主要是基于募投项目建设需要。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方向，有助于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排及公司的发展战略和规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次提供借款后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，上海新昇已开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见2020年5月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《沪硅产业关于签订募集资

金专户存储三方监管协议的公告》。

公司及上海新昇将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定要求规范使用募集资金。

六、履行的决策程序

2020年6月16日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司上海新昇增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司上海新昇进行增资。

同时，独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

七、监事会、独立董事意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次使用部分募集资金和自有资金对全资子公司上海新昇进行增资用于实施“300mm 硅片二期”，是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分募集资金和自有资金对全资子公司增资实施募投项目。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资用于实施“300mm 硅片二期”，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。同意公司使用部分募集资金和自有资金对全资子公司上海新昇增资实施募投项目。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司上海新昇增资实施募投项目事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合募集资金使用安排，

不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程序。

因此，保荐机构对公司本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司上海新昇增资实施募投项目的事项无异议。

(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

张博文

张博文

曹岳承

曹岳承

